公司代码:688123　　公司简称:聚辰股份

聚辰半导体股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细披露了可能面对的风险,提请投资者注意查阅。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据第二届董事会第八次会议决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.70元(含税),预计分配现金红利总额为3,262.73万元(含税),占2021年度归属于上市公司股东的净利润之比为30.14%。本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记之日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

第二节 公司基本情况

一、公司简介

1、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	聚辰股份	688123	/

2、公司存托凭证简况

3、联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	袁丽伟	鲁华强
办公地址	上海市自由贸易试验区松涛路647弄12号	
电话	021-50802005	
电子信箱	investors@giantec-semi.com	

二、报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1、主营业务情况

公司是一家全球化的集成电路设计高新技术企业,专门从事高性能、高品质集成电路产品的研发设计和销售,并提供应用解决方案和技术支持服务。公司目前拥有非易失性存储芯片、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要产品线,产品广泛应用于智能手机、液晶面板、计算机及周边、汽车电子、工业控制、通讯、蓝牙模块、白色家电、医疗仪器等众多领域。

2、主要产品情况

(1)非易失性存储芯片

1)EEPROM

EEPROM是一类通用型的非易失性存储芯片,主要用于各类设备中存储小规模、经常需要修改的数据,通常可确保100年100万次擦写,在1Mb及以下容量区间具备性价比优势,具体应用包括智能手机摄像头模组内存储镜头与图像的矫正参数、汽车电子控制单元以及娱乐系统、液晶显示等外围部件内存储控制参数、液晶面板内存储参数和配置文件、内存条温度传感器内存储温度参数、蓝牙模块内存储控制参数等。

公司EEPROM产品线包括I2C、SPI和Microwire等标准接口的系列EEPROM产品,以及主要应用于计算机和服务器内存条的SPD EEPROM产品。公司的EEPROM产品具有高可靠性、宽电压、高兼容性、低功耗等特点,常温条件下的耐擦写次数最高可达400万次,数据存储时间最长可达200年,被评为2013-2019年期间上海名牌产品,产品广泛应用于智能手机、液晶面板、计算机及周边、汽车电子、工业控制、蓝牙模块、通讯、白色家电、医疗仪器等领域。

2)NOR Flash

NOR Flash与EEPROM同为满足中低容量存储需求的非易失性存储器,两者在技术上具有一定相通性,但在性能方面有所差异,NOR Flash更适合对擦写次数与数据可靠性要求不高但对数据存储量要求较高的应用领域,通常可确保20年10万次擦写,广泛应用于AMOLED手机屏幕、TDDI触控芯片、蓝牙模块等消费电子产品领域以及汽车电子、安防监控、可穿戴设备、物联网等领域。相较于市场同类产品,公司研发的NOR Flash产品具有更可靠的性能和更强的温度适应能力,耐擦写次数从10万次水平提升到20万次以上,数据保持时间超过50年,适应的温度范围达-40℃-125℃,并在功耗、数据传输速度、ESD及LU等关键性能指标方面达到业界领先水平。

(2)音圈马达驱动芯片

音圈马达是摄像头模组内用于推动镜头移动进行自动聚焦的装置,音圈马达驱动芯片为与音圈马达匹配的驱动芯片,用于控制音圈马达来实现自动聚焦功能,主要应用于智能手机摄像头领域。常见的三类音圈马达驱动芯片包括开环式音圈马达驱动芯片、闭环式音圈马达驱动芯片和OIS光学防抖音圈马达驱动芯片。

公司开环式音圈马达驱动芯片具有聚焦时间短、体积小、误差率低等优点,于2019年入选《上海市创新产品推荐目录》。同时,公司基于在EEPROM领域的技术优势,自主研发了集成音圈马达驱动芯片与EEPROM二合一产品,大大减小了两颗独立芯片在摄像头模组中占用的面积,提升了产品的竞争力。此外,公司已与部分头部智能手机厂商合作进行闭环式和光学防抖音圈马达驱动芯片产品的开发,以满足中高端智能手机产品的市场需求。

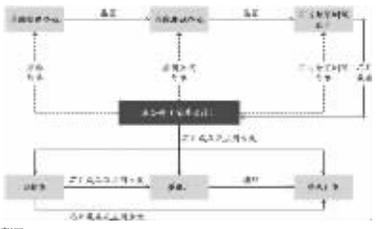
(3)智能卡芯片

智能卡芯片是指粘贴或镶嵌于CPU卡、逻辑加密卡、RFID标签等各类智能卡(又称IC卡)中的芯片产品,内部包含了微处理器、输入/输出设备接口及存储器(如EEPROM),可提供数据的运算、访问控制及存储功能。智能卡芯片一般分为CPU卡芯片、逻辑加密卡芯片和RFID芯片,常见的应用包括交通卡、门禁卡、校园卡、会员卡等。

公司的智能卡芯片产品是将EEPROM技术与下游特定应用相结合的一类专用芯片,产品系列包括CPU卡系列、逻辑卡系列、高频RFID系列、NFC Tag系列和Reader系列,主要产品包括双界面CPU卡芯片、非接触式/接触式CPU卡芯片、非接触式/接触式逻辑卡芯片、RFID芯片、读卡器芯片等。公司智能卡芯片产品广泛应用于公共交通、公共事业、校园一卡通、身份识别、智能终端等领域。公司是住建部城市一卡通芯片供应商之一,产品曾通过中国信息安全测评中心的EAL4+安全认证,双界面CPU智能卡芯片已获得国家密码管理局颁发的商用密码产品型号二级证书,智能卡芯片产品被评为2013-2019年期间上海名牌产品。

(二)主要经营模式

公司主要经营模式为典型的Fabless模式,在该模式下只从事集成电路产业链中的芯片设计和销售环节,其余环节委托给晶圆制造企业、封装测试企业代工完成,公司取得芯片成品后,再通过经销商或直接销售给模组厂或整机厂商。公司的整体业务流程如下图所示:



(三)所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事集成电路产品的研发设计和销售,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”;根据《国民经济行业分类(GB/T 4754—2017)》,公司所处行业为“6520集成电路设计”。

(1)集成电路设计行业发展情况

集成电路设计处于集成电路产业链的上游,负责芯片的开发设计。集成电路设计行业是典型的技术密集型行业,是集成电路行业整体中对科研水平、研发实力要求较高的部分,芯片设计水平对芯片产品的功能、性能和成本影响较大,因此芯片设计的能力是一个国家在芯片领域能力、地位的集中体现之一。经过十年“创芯”发展,国内集成电路产业呈现集聚态势,逐步形成以设计业为龙头,封装测试业为主体,制造业为重点的产业格局。在国内集成电路行业中,设计业始终是最具发展活力的领域,是我国集成电路产业发展的源头和驱动力量。根据中国半导体行业协会统计,2021年中国集成电路设计业销售额达4,519亿元,同比增长19.6%,保持快速、平稳增长态势。除了行业规模显著增长外,集成电路行业的产业结构也不断优化,附加值较高的设计环节销售额占集成电路行业总销售额比例稳步提高,从2016年的37.93%上升到2021年的43.21%,已成为集成电路产业链中比重最大的环节。

(2)非易失性存储芯片市场发展情况

1)EEPROM市场发展情况

EEPROM凭借其高可靠性、百万次擦写、低成本等诸多优点,长期以来满足了消费电子、计算机及周边、工业控制、白色家电、通信等传统应用领域稳定的数据存储需求,市场规模在2016年之前呈现平稳发展的态势。随着智能手机摄像头模组升级和物联网的发展,EEPROM以其自身优势,迅速开拓了智能手机摄像头、汽车电子、智能电表、智能家居、可穿戴设备等新型市场,与此同时,传统应用领域的快速智能化发展也为EEPROM的需求提升增添了助力,因此EEPROM市场规模在2016-2017年间出现拐点。

智能手机摄像头和汽车电子已成为EEPROM市场增长的主要驱动力。在5G商用带动智能手机存量替换、多摄渗透率提升以及摄像头模组升级等因素的驱动下,智能手机摄像头对EEPROM的需求量持续增长,根据赛迪顾问数据,到2023年智能手机摄像头领域对EEPROM的需求量将达到55.25亿颗。此外,随着汽车智能网联、电动化趋势的不断发展,汽车电子产品的渗透率将快速提升,进一步拉动了EEPROM市场规模增长,根据赛迪顾问数据,预计到2023年汽车电子领域对EEPROM的需求量将达到23.87亿颗。

液晶面板和DDR内存条亦为EEPROM的重要应用领域。随着高清显示、4K的需求增加,近年来全球大尺寸液晶面板的需求保持稳步增长,进而拉动了液晶面板对EEPROM需求量的提升,根据赛迪顾问数据,预计到2023年液晶面板领域EEPROM需求量将达到9.68亿颗。此外,在居家办公、在线教育以及云计算、大数据等因素的驱动下,计算机和服务器的需求规模显著提升。根据IDC统计,2021年全球计算机和服务器的出货量分别达到34,830.00万台和1,353.90万台,同比增长14.80%和6.90%。以每台计算机搭载1-2条内存,每台服务器搭载10-12条内存计算,2021年计算机和服务器领域对DDR内存的需求量超过4.84亿条。下游DDR内存模组行业规模的提升相应带动了应用于DDR内存条的SPD EEPROM需求量的增加。

2)NOR Flash市场发展情况

NOR Flash的传统应用以功能手机内存为主,2010-2016年随着智能手机的快速崛起,NOR Flash市场规模逐渐下降。虽然2016年以后功能手机市场需求基本筑底,但在智能手机新技术、蓝牙模块、可穿戴设备、汽车电子、安防监控、工业控制、物联网等新兴应用领域的带动下,NOR Flash在AMOLED手机屏幕、TWS耳机以及TDDI触控芯片等方面的应用快速增长,市场规模开始反弹。根据CINNO Research统计,NOR Flash的市场规模从2017年的24亿美元增长至2019年的28亿美元左右,预计2022年市场规模将达到37亿美元。

(3)音圈马达驱动芯片市场发展情况

智能手机的摄像头模组是音圈马达驱动芯片的重要应用领域,对智能手机的需求增加以及更高的照片拍摄需求促使目前音圈马达驱动芯片市场保持稳定增长。根据沙利文统计,2014年至2018年期间,全球音圈马达驱动芯片市场规模的复合年均增长率为4.48%,2018年全球市场规模达到1.43亿美元。随着多摄像头和前置自动对焦摄像头应用的增加,音圈马达驱动芯片市场规模将进一步增长,根据沙利文数据,预计到2023年音圈马达驱动芯片市场规模将达到2.73亿美元。

(4)智能卡芯片市场发展情况

受益于智能卡在移动通信、金融支付、公共事业等领域应用的增加,根据沙利文统计,从2014年到2018年,全球智能卡芯片出货量从90.19亿颗增长到155.89亿颗,复合年均增长率为14.66%,市场规模从28.14亿美元增长到32.70亿美元,复合年均增长率为3.83%。亚太地区的收入比重最大,其中中国、印度、日本、韩国是主要市场。随着智能卡芯片技术的进步和应用领域的扩展,预计未来智能卡芯片收入将持续增长,根据沙利文数据,到2023年全球智能卡芯片出货量将达到279.83亿颗,市场规模将达到38.60亿美元。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)非易失性存储芯片行业竞争格局与公司的市场地位

1)EEPROM行业竞争格局与公司的市场地位

全球市场上的EEPROM供应商主要来自欧洲、美国、日本和中国大陆地区,除公司外还包括意法半导体(STMicroelectronics)、微芯科技(Microchip Technology)、安森美半导体(ON Semiconductor)、艾普凌科(ABLIC, Inc.)等。在工业级EEPROM竞争领域,以公司为代表的境内供应商产品已广泛应用于智能手机、液晶面板、计算机及周边、工业控制、蓝牙模块、通讯、白色家电、医疗仪器等众多领域,目前公司已成为智能手机摄像头和液晶面板EEPROM芯片的领先品牌,在该等细分领域奠定了领先优势;以意法半导体为代表的境外供应商由于其整体业务规模较大、全球知名度较高,产品应用领域和客户资源相对更为广泛,在工业控制、通讯、白色家电等国产替代比率相对较低的领域占有相对较高的市场份额。在汽车级EEPROM竞争领域,目前境外竞争对手已形成较为成熟的汽车级EEPROM产品系列,技术水平和客户资源优势相对明显;作为境内领先的汽车级EEPROM产品供应商,公司已拥有A2等级和A3等级的全系列汽车级EEPROM产品,主流容量的A1等级的汽车级EEPROM产品也已于2021年末通过了第三方权威机构的AEC-Q100可靠性标准认证,但在高等级汽车级EEPROM领域还有较大拓展空间。

2)NOR Flash行业竞争格局与公司的市场地位

NOR Flash芯片设计企业相对集中,前五大NOR Flash芯片设计企业占据逾90%的市场份额。近年来,随着国际存储器龙头企业逐步退出中低容量NOR Flash市场,产能或让位于汽车电子、工业控制等应用领域的高容量产品,或专注于DRAM和NAND Flash业务,兆易创新、华邦电子、旺宏电子等厂商的市场份额持续上升,NOR Flash行业目前已形成了华邦电子、旺宏电子、兆易创新、赛普拉斯和美光科技的五强竞争格局。目前公司开发的中低容量的NOR Flash产品尚未导入市场,在NOR Flash领域还有较大提升空间。

(2)音圈马达驱动芯片行业竞争格局与公司的行业地位

全球市场上的音圈马达驱动芯片供应商主要来自韩国、日本、美国和中国大陆地区,除公司外还包括韩国动运(DONGWOON)、罗姆半导体(ROHM Semiconductor)、旭化成(AKM)、安森美半导体(ON Semiconductor)、天钰科技(Fitipower)等。在开环式音圈马达驱动芯片领域,主要厂商包括韩国动运、公司和天钰科技,公司已初步建立了竞争优势和品牌影响力;生产闭环式和光学防抖(OIS)音圈马达驱动芯片的厂商相对较少,主要包括罗姆半导体、旭化成、安森美半导体等,公司已与部分头部智能手机厂商合作进行闭环式和光学防抖音圈马达驱动芯片产品的开发,满足中高端智能手机产品的市场需求。

(3)智能卡芯片行业竞争格局与公司的行业地位

相较于全球主要的智能卡芯片厂商,国内智能卡芯片厂商规模较小,主要集中在华大半导体、紫光微电子、大唐微电子、上海复旦及国民技术等厂商。根据沙利文统计,2018年全国收入排名前五的智能卡芯片厂商包括英飞凌、恩智浦半导体、华大半导体、上海复旦及紫光微电子,合计占中国智能卡芯片市场总收入的65%左右。公司的智能卡芯片业务收入在国内市场中的占有率较小,在该领域的市场份额有较大提升空间。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司主要产品所处行业的主流技术水平、最高技术水平以及未来的技术发展方向如下:

产品类别		主流技术水平	最高技术水平	未来的技术进展方向
EEPROM	工业级	1.工作温度:-40℃-85℃; 2.工作电压:1.7V-5.5V; 3.可靠性: (1)擦写次数:常温下100万次; (2)数据保存时间:常温下40年; 4.静态功耗:1-6μA	1.工作温度:-40℃-85℃; 2.工作电压:1.1V-5.5V; 3.可靠性: (1)擦写次数:常温下400万次; (2)数据保存时间:常温下200年; 4.静态功耗:1μA	1.进一步降低芯片功耗,特别是静态功耗,以适应系统低功耗的需求; 2.进一步提升芯片的可靠性,扩大产品在包括过程计量、环境感知以及Ib移动平台和物联网等领域的应用
	汽车级	1.工作温度:-40℃-125℃; 2.工作电压:1.7V-5.5V; 3.可靠性: (1)擦写次数:常温下400万次,125℃下60万次; (2)数据保存时间:常温下100年	1.工作温度:-40℃-140℃; 2.工作电压:1.7V-5.5V; 3.可靠性: (1)擦写次数:常温下400万次,140℃下40万次; (2)数据保存时间:常温下200年	1.支持更宽的工作温度范围,能适应更恶劣的工作环境/应用场景; 2.支持更宽的工作电压,以适应系统低功耗的需求; 3.进一步提升芯片的可靠性,降低系统故障发生率
NOR Flash		1.工作温度:-40℃-125℃; 2.工作电压:1.65V-3.6V; 3.可靠性: (1)擦写次数:常温下10万次; (2)数据保存时间:常温下20年; 4.静态功耗:1-3μA	1.工作温度:-40℃-125℃; 2.工作电压:1.1V-3.6V; 3.可靠性: (1)擦写次数:常温下20万次; (2)数据保存时间:常温下50年; 4.静态功耗:1μA	1.进一步降低芯片功耗,缩短擦写时间,以适应系统低功耗的需求; 2.进一步提升芯片的可靠性,扩大产品在包括过程计量、环境感知等领域的应用; 3.支持更宽的工作电压,以适应系统低功耗的需求; 4.进一步提升芯片的可靠性,降低系统故障发生率
音圈马达驱动芯片		1.工作电压:2.2V-3.6V; 2.工作温度:-40℃-85℃; 3.算法最快稳定时间:65个音圈马达满幅跨距; 4.算法最大容忍马达频率变化范围:±30%	1.工作电压:2.2V-4.8V; 2.工作温度:-40℃-85℃; 3.算法最快稳定时间:03个音圈马达满幅跨距; 4.算法最大容忍马达频率变化范围:±60%; 5.集成EEPROM或Flash; 6.采用闭环和光学防抖(OIS)技术	1.提高工作电压范围,满足手机低功耗需求; 2.减小芯片面积; 3.采用马达参数自检测方式,提高音圈马达周期变化容忍度,提升马达稳定速度; 4.采用闭环和光学防抖(OIS)技术控制音圈马达
智能卡芯片		1.嵌入式EEPROM存储器耐擦写次数为10万次,数据保存时间为10年; 2.以嵌入式EEPROM作为存储器,采用0.18μm工艺制程; 3.ISO/IEC14443 Type A协议的逻辑加密智能卡芯片最小工作场强为0.25A/M	1.嵌入式EEPROM存储器耐擦写次数为50万次,数据保存时间为25年; 2.以嵌入式EEPROM作为存储器,采用0.13μm工艺制程; 3.ISO/IEC14443 Type A协议的逻辑加密智能卡芯片最小工作场强为0.2A/M	1.更高的耐擦写次数和更长的数据保存时间; 2.随着代工厂工艺的进步和升级,采用更先进的工艺制程,实现更小的芯片面积和更低的功耗; 3.ISO/IEC14443 Type A协议的逻辑加密智能卡芯片实现更小的工作场强,以适应更多应用场景

三、公司主要会计数据和财务指标

1、近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

主要会计数据和财务指标	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,639,096,446.28	1,556,469,946.19	5.31	1,415,897,723.66
归属于上市公司股东的净资产	1,524,493,233.48	1,461,079,276.65	4.34	1,328,307,256.42
营业收入	544,063,914.62	493,852,006.62	10.17	512,371,896.61
归属于上市公司股东的净利润	108,251,077.72	162,947,716.63	-33.57	96,106,151.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,177,276.31	60,142,853.22	41.62	97,911,566.97
经营活动产生的现金流量净额	56,114,989.69	92,630,900.59	-39.42	73,773,730.34
加权平均净资产收益率(%)	7.25	11.71	减少4.46个百分点	25.73
基本每股收益(元/股)	0.90	1.35	-33.33	1.05
稀释每股收益(元/股)	0.89	1.35	-34.07	1.05
研发投入占营业收入的比例(%)	13.66	10.52	增加3.14个百分点	11.24

2、报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

主要财务数据	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	133,232,337.00	131,247,812.39	127,907,477.86	151,666,287.57
归属于上市公司股东的净利润	16,498,934.69	49,253,223.82	16,844,621.58	25,654,297.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,385,981.34	14,349,828.47	26,199,337.71	28,242,127.79
经营活动产生的现金流量净额	-5,835,928.14	53,799,873.56	-6,511,407.05	14,662,452.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

1、普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,683
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,900
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
江西和光投资管理有限公司		25,703,785	21.27	25,703,785	25,703,785	无		境内非国有法人
聚辰半导体(香港)有限公司		11,268,562	9.33			无		境外法人
嘉善市亦乘股权投资合伙企业(普通合伙)		9,778,611	8.09			无		其他
北京珠珈天璨投资中心(有限合伙)	-4,799,993	6,375,568	5.28	147,047	147,047	无		其他
北京珠珈天璨投资中心(有限合伙)		5,587,777	4.62	5,587,777	5,587,777	无		其他
武汉珠珈栢源兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)		5,587,777	4.62	5,587,777	5,587,777	无		其他
澜起投资有限公司	5,398,000	5,398,000	4.47			无		境内非国有法人
宁波梅山保税港区登砂全投资管理合伙企业(有限合伙)	-863,447	4,600,206	3.81			无		其他
聚祥有限公司	-1,309,189	4,131,149	3.42			无		境外法人
宁波梅山保税港区登砂高投资管理合伙企业(有限合伙)	-333,672	1,752,017	1.45			无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明:(1)江西和光、北京珠珈与武汉珠珈均系公司实际控制人陈作涛先生所控制企业,互为关联方;(2)登砂全与登砂高与系公司员工持股平台,执行事务合伙人均系宁波梅山保税港区臻辰投资管理有限责任公司,互为关联方;(3)公司未知其他股东之间的关联关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明:/

存托凭证持有人情况

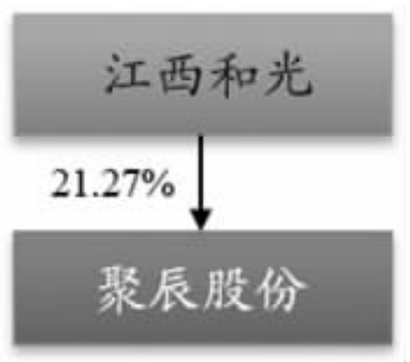
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

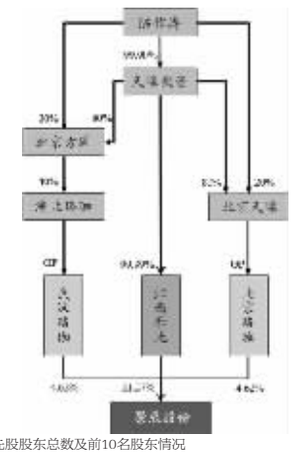
2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用



3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用



4、报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

√适用 □不适用

五、公司债券情况

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

关于报告期内主要经营情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:688123　证券简称:聚辰股份　公告编号:2022-022

聚辰半导体股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.70元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中予以明确。

●在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本方案尚需提交公司股东大会批准方可实施。

一、公司2021年度利润分配方案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币276,358,441.81元。根据第二届董事会第八次会议决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配2021年度利润,公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.70元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。按照公司截至2021年12月31日的总股本120,841,867股计算,公司本次利润分配预计派发现金红利总额为32,627,304.09元(含税),占2021年度归属于上市公司股东的净利润之比为30.14%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、审议程序和专项意见

(一)董事会审议情况

2022年4月29日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《聚辰半导体股份有限公司2021年度利润分配方案》,决议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.70元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

(二)独立董事意见

独立董事认为,公司2021年度利润分配方案系基于公司盈利水平、财务状况、日常经营和长远发展的前提下做出的,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《聚辰股份公司章程》、《聚辰股份公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市后三年内分红回报规划》的有关规定,在兼顾公司的可持续性发展的同时实现了对投资者合理的回报。

综上所述,公司独立董事对《聚辰半导体股份有限公司2021年度利润分配方案》无异议。

(三)监事会审议情况

2022年4月29日,公司第二届监事会第八次会议审议通过了《聚辰半导体股份有限公司2021年度利润分配方案》,同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.70元(含税)。

监事会认为,公司2021年度利润分配方案兼顾了投资者合理的回报与公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定,公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司或全体股东利益的情形。

三、风险提示

1、本次利润分配兼顾了公司的可持续性发展以及对投资者的合理回报,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等产生实质性影响。

2、本方案尚需提交公司股东大会批准方可实施,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:688123　证券简称:聚辰股份　公告编号:2022-028

聚辰半导体股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2022年4月29日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由监事会主席丁遂先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司监事会2021年度工作报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司2021年度利润分配方案》

(下转B710版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)杨翌保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	200,841,522.87	50.75
归属于上市公司股东的净利润	57,234,426.11	246.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,847,262.30	356.76
经营活动产生的现金流量净额	61,797,640.47	不适用
基本每股收益(元/股)	0.47	238.31
稀释每股收益(元/股)	0.47	235.72
加权平均净资产收益率(%)	3.68	增加2.56个百分点
研发投入合计	21,460,948.90	48.84
研发投入占营业收入的比例(%)	10.69	减少0.13个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,697,003,823.55	1,639,096,446.28	3.53
归属于上市公司股东的所有者权益	1,581,202,640.72	1,524,493,233.48	4.18

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-19,708,666.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	107,605.82	
减:所得税影响额	-1,958,389.92	
少数股东权益影响额(税后)	12,176.09	
合计	-17,612,836.19	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	50.75	主要原因系在DDR5内存条高用的驱动下,公司应用于DDR5内存模组的SPD EEPROM产品于报告期内大批量出货,带动营业收入快速增长;此外,公司应用于汽车电子、工业控制领域的EEPROM产品销量及收入于报告期内亦实现了较快速增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	356.76	报告期内,公司扣除非经常性损益的净利润增幅高于营业收入增幅,主要原因系受公司应用于DDR5内存条、汽车电子及工业控制等高附加值产品的产品特别是SPD EEPROM产品的销售占比提升,以及公司通过产品价格体系调整等因素的综合影响,公司销售毛利率有较大幅度提高,带动扣除非经常性损益的净利润高速增长。
归属于母公司股东的净利润	246.9	
基本每股收益	238.31	报告期内,公司净利润增幅低于扣除非经常性损益的净利润增幅,主要原因系公司间接持有中芯国际股份,按照出资份额确认的公允价值变动收益减少本报告期业绩约2,190.32万元。
稀释每股收益	235.72	
加权平均净资产收益率	增加2.56个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,763.36万元,主要系公司业务规模增长使得销售商品收到的现金增长所致。
研发投入合计	48.84	主要原因系公司针对部分研发人员实施2021年限制性股票激励计划,报告期内确认的股份支付费用有较大幅度增长;此外,报告期内研发人员薪酬及研发项目开支亦有一定幅度的增长。
研发投入占营业收入的比例	减少0.13个百分点	主要系报告期内公司营业收入快速增长所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,900	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
江西和光投资管理有限公司	境内非国有法人	25,703,785	21.27	25,703,785	25,703,785	无		
聚辰半导体(香港)有限公司	境外法人	11,268,562	9.33			无		
嘉善市亦乘股权投资合伙企业(普通合伙)	其他	9,778,611	8.09			无		
北京珠珈天璨投资中心(有限合伙)	其他	5,587,777	4.62	5,587,777	5,587,777	无		
武汉珠珈栢源兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5,587,777	4.62	5,587,777	5,587,777	无		
澜起投资有限公司	境内非国有法人	5,489,500	4.54			无		
北京新越成长投资中心(有限合伙)	其他	5,169,873	4.28	147,047	147,047